

別表2 材料別RoHS 6物質の含有リスクマップ(参考)

このリスクマップはあくまでも参考であり、含不含の判断には使用しないこと。

- ・測定は、機械的に分解可能な単一部材毎に行う。
- ・ユニットは単一部品さらに単一部材に分割し、部品ないし部材毎に測定する。

RoHS規制物質の存在リスク (参考)							
リスク区分(色別)		低	中	高			
		低リスク	中リスク	高リスク	非該当		
部品材料		Hg	Cd	Pb	Cr()	PBBs	PBDEs
機械部品 組部品	金属フレーム(表面処理なし)	低	中	低	中		
	樹脂外装	低	低	低	低	低	中
	電源ケーブル、コード	低	高	高	低	低	低
	フィルムセンサー	低	高	中	低	低	中
	ヒートシンク	低	低	中	低		
	ねじくぎ/締結部材	低	中	中	高		
	CRTガラス、ガラス金属密封接合	低	中	高	低		
	蛍光粉塗装(例えばCRT)	低	高	低	低		
	LCDパネル/ディスプレイ	高	低	高	高	低	低
	PDPパネル/ディスプレイ	高	低	高	高	低	低
バックライト	高	低	高	中			
プリント 回路基板 部品	プリント回路基板	低	低	低	低	低	
	コネクタ(プラグ、ソケット)	中	低	高	低	低	高
	電解コンデンサ	低	中	高	低	低	中
	チップコンデンサ	低	中	中	低	低	中
	チップ抵抗	低	高	中	低	低	低
	ダイオード	低	中	中	低	低	低
	ヒューズ	低	中	高	低	低	低
	はんだ	低	中	高	低		
	端子表面処理	低	高	高	低		
	IC及びBGA等の集積回路	低	低	高	低	低	高
	水銀接点リレー	高	低	中	低	低	低
	水銀接点スイッチ	高	低	中	低	低	低
	機械式スイッチ	中	高	中	低	低	低
トランス	低	中	高	低	低	中	
アタッチメント (アクセ リ)	リモートコントロール	低	高	高	低	低	低
	外部ケーブル(USB等)	低	高	高	低	低	低
	外部電源	低	高	高	低	低	中
材料・ 補材	塗料、インクまたは類似の表面処理	低	高	高	中	低	低
	接着剤	中	中	中	低	中	中
	ポリ塩化ビニル(PVC)	低	高	高	中	低	中
	ポリスチレン、ABS、ポリエチレン、ポリエステル	低	中	中	低	低	高
	ゴム、ラバー	低	中	中	低	低	中
	その他樹脂	低	中	中	低	低	中
	色材(顔料)全プラスチック	中	高	高	高		
	金属	低	中	中	中		
	ステンレス	低	低	中	高		
	その他鋼材	低	低	低	高		
	フリー快削鋼材	低	低	高	低		
	銅合金	低	高	高	低		
	アルミニウム合金	低	低	高	低		
	クロムメッキ	低	低	低	低		
	亜鉛メッキ	低	高	高	高		
	その他金属メッキ	低	高	低	高		
その他ガラス	低	中	高	中			
セラミック	低	中	高	低			